

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2000049195 A**

(43) Date of publication of application: **18.02.00**

(51) Int. Cl.

**H01L 21/60**

(21) Application number: **10216848**

(22) Date of filing: **31.07.98**

(71) Applicant: **DAINIPPON PRINTING CO LTD**

(72) Inventor:  
**YAGI YUTAKA**  
**TAKEI SHIGEO**  
**SERIZAWA TORU**  
**SEKIGUCHI TAKESHI**

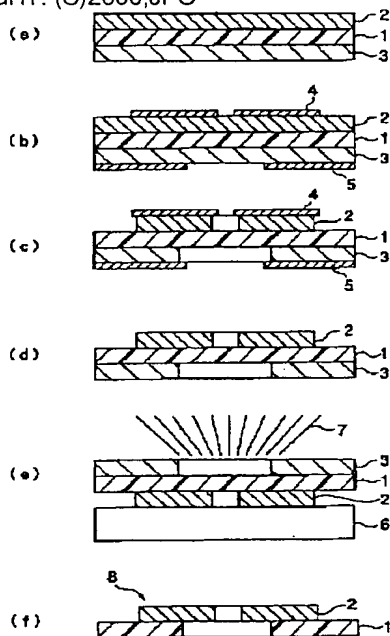
(54) **PRODUCING METHOD OF ELECTRONIC COMPONENT MEMBER**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a producing method for a member of electronic components.

SOLUTION: Resist patterns 4, 5 are formed individually on metallic foils 2, 3 which are laminated on both sides of a polyimide film 1, and both of the metallic foils 2, 3 are simultaneously etched in an etching liquid, and then the resist patterns 4, 5 are exfoliated. After that, the polyimide film 1 is patterned by plasma etching with the use of only the metallic foil 3 as a mask, and then the metallic foil 3 which has been used as a mask is eliminated. As a result, as a member for electronic components, a laminated body 8 can be obtained, which consists of the patterned polyimide film 1 and the patterned metallic foil 2. Because of only once requirement for plate making, it is possible to produce the member for electronic components at lower costs, and it is also possible to obtain the high quality member which is laminated by the polyimide film pattern and the metallic foil pattern at their high positional precision.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テマコード	(参考)
H01L 21/60	311	H01L 21/60	311	W 4M105

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全4頁)

(21) 出願番号 特願平10-216848

(22) 出願日 平成10年7月31日 (1998.7.31)

(71) 出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 八木 裕

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72) 発明者 竹居 滋郎

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74) 代理人 100096600

弁理士 土井 育郎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子部品用部材の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 低コストで高品質のものが得られる電子部品用部材の製造方法を提供する。

【解決手段】 ポリイミドフィルム1の両面に積層した金属箔2、3の上にそれぞれ対してレジストパターン4、5を形成し、両方の金属箔2、3をエッチング液にて同時にエッチング処理した後、レジストパターン4、5を剥離してから、片方の金属箔3をマスクに利用してプラズマエッチングすることでポリイミドフィルム1をパターニングし、しかる後にマスクに使用した金属箔3を除去することで、パターニングされたポリイミドフィルム1とパターニングされた金属箔2との積層体8である電子部品用部材を得る。製版が一回でよいので低コストで製造でき、しかもポリイミドフィルムのパターンと金属箔のパターンとが良好な位置精度を持って積層された高品質のものを得ることができる。

